|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | | | | | | | | | | | 产品图片 | |
| 产品类别  （可多选） | □ 处理器 □ 存储器 □ 电源管理 □ 接口  □ 信息安全 □ 网络互联 □ FPGA □ MCU  □ 信息娱乐 □音视频 □ 传感雷达芯片  □ 功率器件 □ IGBT/IPM □ SiC □ 功率模块  □ MEMS传感器件: □ 运动 □ 温度 □ 压力  □ SoC □ 其它： ***（注：请勾选后删除其它无关选项）*** | | | | | | | | | | |
| 产品名称/型号 |  | | | | | | | | | | |
| 芯片最大功耗 |  | | | | | | | | | | | | |
| 内含NVM容量 |  | | | | | | | | | | | | |
| 芯片封装信息 | □ 塑封 □ 陶瓷封装 □ 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 功能描述与应用领域简介 | *限300字* | | | | | | | | | | | | |
| 主要技术指标 | *限200字* | | | | | | | | | | | | |
| 芯片特点与  创新处 | *限200字* | | | | | | | | | | | | |
| 对标产品型号 |  | | | | | | | | | | | | |
| 产品应用情况 | □ 已前装，进入 家Tier1供应商；在 款车型前装应用，总量： 颗  □ 已后装，于 年开始供货，总量： 颗  □ 有样片，在 家Tier1验证测试或在 家整车实验  □ 设计流片阶段 ***（注：请勾选后删除其它无关选项）*** | | | | | | | | | | | | |
| 企业成立时间 |  | | 注册资本 | | |  | | 员工总数 | |  | | | |
| 企业类型  下拉菜单 | □科研院所 □国有企业 □民营企业 □中外合资 □其他（请自填）  ***（注：请勾选后删除其它无关选项）*** | | | | | | | | | | | | |
| 联系方式 | 姓名 | ***（必填）*** | | 座机 | ***（必填）*** | | 手机 | |  | | 邮箱 | | ***（必填）*** |
| 企业网站 |  | | | | | | | | | | | | |
| 标准认证描述 | ISO26262、AEC-QXXX、AQG324认证情况： | | | | | | | | | | | | |
| ***（注：已获得体系、产品认证的，请提供相关证书复印件； 未完成论证，但正在进行论证试验的，请提供试验计划。）*** | | | | | | | | | | | | |
| 已通过AEC-Q100测试项目  (其他标准的试验项目请补充) | □A1(PC) □A2( THB or HAST) □A3( AC or UHAT or THT) □A4(TC)  □A5(PTC) □A6(HTSL)  □B1(HTOL) □B2(ELFR) □B3(EDR)  □C1(WBS) □C2(WBP) □C3(SD) □C4(PD) □C5(SBS) □C6(LI)  □D1(EM) □D2(TDDB) □D3(HCI) □D4(NBTI) □D5(SM)  □E1(TEST) □E2(HBM) □E3(CDM) □E4(LCH\_U) □E5(ED) □E6(FG) □E7(CHAR) □E9(EMC) □E10(SC) □E11(SER) □E12(LF)  □F1(PAT) □F2(SBA)  □G1(MS) □G2(VFV) □G3(CA) □G4(GFL) □G5(DROP) □G6(LT)  □G7(DS) □G8(IWV)  □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ | | | | | | | | | | | | |
| **编委建议** | **编委根据提供的材料进行分析，作出相关评价。**  ***（注：本栏企业无需填写，由编委专家组审核提交的AEC-Q1XX认证资料后补充。*** | | | | | | | | | | | | |